****

|  |  |
| --- | --- |
| **Contact pour les lecteurs :** | **Contact pour la presse :** |
| **congatec SAS.** | **SAMS Network**  |
| Luc Beugin | Michael Hennen |
| Téléphone : +33 6 44 32 70 88 | Téléphone : +49-2405-4526720 |
| info@congatec.com[www.congatec.com](http://www.congatec.com/) | info@sams-network.com [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com) |



*Texte et photo disponibles:* [*https://www.congatec.com/fr/congatec/communiques-de-presse.html*](https://www.congatec.com/fr/congatec/communiques-de-presse.html)

**Communiqué de presse**

congatec présente ses solutions de refroidissement ultra-puissantes pour SBC 3,5 pouces

**C’est la masse qui fait toute la différence**

**Deggendorf/Nuremberg, Allemagne, 25 février 2020 \* \*** \* congatec - l'un des principaux fournisseurs de produits informatiques embarqués de haute performance - présente trois nouvelles solutions de refroidissement embarquées de premier plan pour ses cartes SBC de 3,5 pouces. Basées sur les spécifications du PICMG pour les dissipateurs thermiques COM Express standards et grâce à leur grande surface, elles offrent une inertie thermique et une surface de refroidissement maximales pour les SBC 3,5 pouces ultra puissants. La dissipation thermique est standardisée et toutes les solutions sont équipées d'un dissipateur thermique imposant, en métal léger, qui disperse rapidement et efficacement la chaleur résiduelle des points chauds du CPU. En fonction du TDP, le dissipateur thermique peut être complété par des dissipateurs à ailettes passives ou des systèmes de ventilation active. Comme congatec propose également ses trois solutions de refroidissement dans une hauteur standardisée, les OEM peuvent à l'avenir mettre en œuvre des solutions de refroidissement d’encombrement identique pour des exigences TDP comparables. Cela facilitera considérablement l’adaptation des systèmes embarqués de 3,5 pouces à base de SBC sur plusieurs générations de processeurs. Les premières configurations des nouvelles solutions de refroidissement entièrement développées en interne sont optimisées pour l'utilisation des nouveaux SBC 3,5 pouces conga-JC370 basés sur la 8e génération de processeurs Intel® Core™ (nom de code Whiskey Lake).

"Afin de faciliter la conception des systèmes embarqués par nos clients, notre stratégie consiste depuis longtemps à développer également des solutions de refroidissement personnalisées et ultra-résistantes pour tous nos formats, qui sont standardisés et - lorsque le refroidissement est activé - impressionnent par un MTBF extra-long qui non seulement répond à tous les standards industriels communs, mais aussi les dépassent. Dans le cadre de cette stratégie, nous avons également développé une nouvelle solution de refroidissement unique pour nos SBC de 3,5 pouces. Elle diffère considérablement des SBC 3,5 pouces classiques, où le processeur et les E/S se trouvent du même côté de la carte. En montant notre solution sur la face inférieure de la carte, nous laissons beaucoup plus d'espace pour les systèmes de refroidissement massifs tout en facilitant la conception des systèmes par les développeurs, puisque la connexion du boîtier ainsi que le flux d'air interne du système sont standardisés", déclare Martin Danzer, directeur des produits chez congatec, en expliquant que le concept de refroidissement avancé des nouvelles cartes SBC de 3,5 pouces utilise presque tout l’ensemble de l’espace de 146×102 mm.

Les trois systèmes de refroidissement sont conçus pour les SBC de 3,5 pouces et ont été développés en vue des futurs processeurs nécessitant une capacité de refroidissement allant jusqu'à 45 watts dans des modes cTDP-up limités dans le temps. Ils possèdent un dissipateur thermique sans ailettes de refroidissement qui dissipe la chaleur résiduelle vers le boîtier, ainsi qu’un dissipateur thermique passif avec ailettes de refroidissement, et d'une variante de refroidissement actif avec ventilateur intégré. En cas de charges élevées, il est recommandé d'utiliser un ventilateur externe pour la variante de refroidissement passif. Le refroidissement actif est conçu pour un fonctionnement autonome. Afin de rendre l'intégration du système facile et flexible, chacune des solutions de refroidissement ci-dessus est disponible dans des variantes filetées et à trous de forage.

Le système de refroidissement actif par ventilateur, qui est utilisé par exemple dans les systèmes 3,5 pouces équipés de processeurs Intel® Core™ i7 de 25 watts de 8e génération (i7-8665UE / nom de code Whiskey Lake), est spécialement conçu pour fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans des environnements industriels difficiles. Dans ce système de refroidissement complet, les ventilateurs sont non seulement montés de manière très sûre, mais aussi fixés de manière spécifique pour réduire l'usure. De plus, les roulements sont équipés d'un joint spécial et d'un couvercle supplémentaire pour assurer une protection maximale de la mécanique et du lubrifiant. Avec une huile synthétique haute performance comme lubrifiant, le ventilateur a un MTBF de plusieurs décennies - et ce dans la plage de température industrielle de -45 à +85°C et avec une résistance aux chocs et aux vibrations de qualité industrielle.

Pour plus d’informations sur les solutions de refroidissement de congatec pour le nouvel écosystème de cartes SBC 3,5 pouces, visitez : <https://www.congatec.com/en/technologies/35-sbc-based-on-8th-generation-intel-core-mobile-processors.html>

**A propos de congatec**

congatec est une entreprise technologique à forte croissance qui se concentre sur les produits informatiques embarqués. Les modules informatiques haute performance sont utilisés dans une large gamme d'applications et d'appareils dans l'automatisation industrielle, la technologie médicale, les transports, les télécommunications et bien d'autres secteurs verticaux. congatec est le leader mondial du marché des computer-on-modules avec une excellente clientele composée de start-ups comme de grandes entreprises internationales. Fondée en 2004 et basée à Deggendorf, en Allemagne, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 133 millions de dollars US en 2018. Site web : [www.congatec.com](http://www.congatec.com) ou via [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/455449), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) et [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE)

\* \* \*

*Intel et Intel Core sont des marques enregistrées d’Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d’autres pays.*